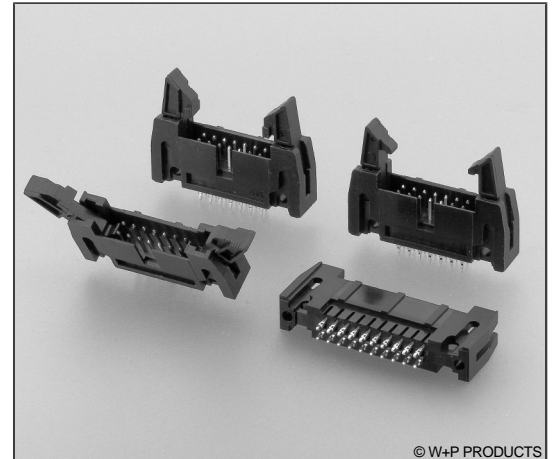


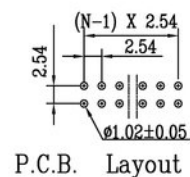
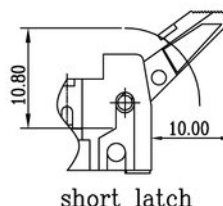
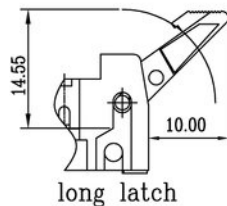
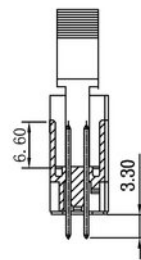
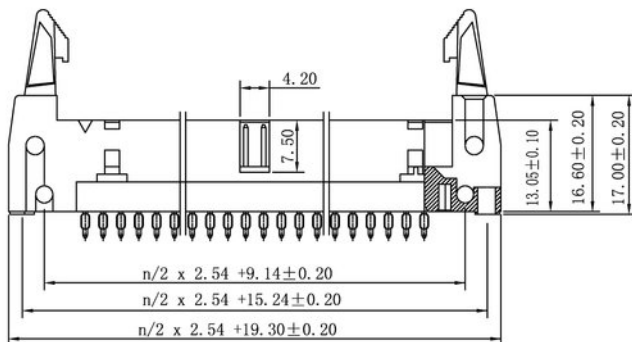
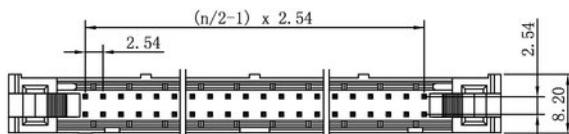
Wannenstiftleisten mit Verriegelung, RM 2,54mm, Press-Fit Box Headers with Latches, 2.54mm Pitch, Press-Fit

Technische Daten / Technical Data

Gehäuse	Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0
Shell	Thermoplastic, rated UL94 V-0
Kontaktmaterial	Vierkantstift 0,635mm, Kupferlegierung
Contact Material	Square pin 0.635mm, copper alloy
Kontaktoberfläche	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni (1,3 ... 2,5µm)
Contact Surface	Acc. to options (see below), over Ni (1.3 ... 2.5µm)
Durchgangswiderstand	< 20mΩ
Contact Resistance	< 20mΩ
Isolationswiderstand	> 1000MΩ
Insulation Resistance	> 1000MΩ
Spannungsfestigkeit	500V _{AC}
Test Voltage	500V _{AC}
Nennspannung	250V _{AC}
Voltage Rating	250V _{AC}
Nennstrom	3A
Current Rating	3A
Temperaturbereich	-40°C ... +105°C
Temperature Range	-40°C ... +105°C
Verarbeitung	Einpresstechnik
Processing	Press-Fit



© W+P PRODUCTS



Einpressen über Stiftspitzen.
Press-in over pin tips.

Einpresszone s. Tech. Informationen.
See technical information for PressFit zones.

Serie	Contacts*	Latches*	Plating*
138PF	40	10	60
	10 14 16 20 26 34 40 50	00 Ohne Hebel W/o latches 10 Kurze Hebel Short latches 20 Lange Hebel (für Gegenstecker mit Zugentlastung) Long latches (for mating connectors with strain relief)	00 Vergoldet Gold plated 60 Au/Sn Au/Sn

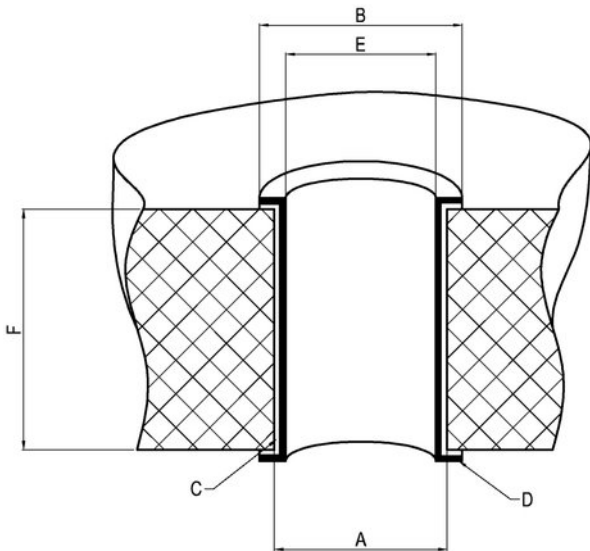
* Dies ist ein **Bestellbeispiel** - bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** - please replace by your specifications.

PressFit Lochdefinitionen

PressFit Hole Definitions

Empfohlene Maße der Einpresszonen unserer PressFit Stift- und Buchsenleisten

Recommended Dimensions of PressFit Through Holes



A	Bohrungs-Ø	Base Hole Ø
B	Ring-Ø	Ring Ø
C	Cu-Schicht	Cu Layer
D	Veredelung	Plating
E	Endloch-Ø	Final Hole Ø
F	Leiterplattendicke	PCB Thickness

Serie Series	RM / Pitch [mm]	A [mm]	B [mm]	C [µm]	D Option [µm]		E [mm]	F [mm]
					Sn	Au/Ni		
943PF, 944PF 943PFS, 944PFS	2,54	1,15±0,03	min. 1,35	min. 25	max. 1,5 Sn	0,05~0,2 Au 2,5~5 Ni	1,00 ^{+0,09} _{-0,06}	min. 1,60
314PF	2,00	0,89±0,03	min. 1,30	min. 30	max. 1,5 Sn	0,05~0,2 Au 2,5~5 Ni	0,81±0,05	min. 1,60
153PF	2,54	1,15±0,03	min. 1,35	min. 25	5~15 Sn	0,05~0,2 Au 2,5~5 Ni	1,00 ^{+0,09} _{-0,06}	min. 1,60
153PF-38	2,54	1,15±0,03	min. 1,35	min. 25	5~15 Sn	0,05~0,2 Au 2,5~5 Ni	1,00 ^{+0,09} _{-0,06}	min. 2,50
138PF	2,54	1,00±0,03	min. 1,35	min. 25	max. 1,5 Sn	0,05~0,2 Au 2,5~5 Ni	1,00±0,05	min. 1,60